

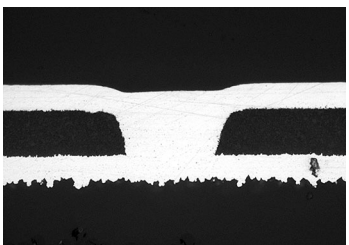
新めっき剤を開発

品質維持して生産性向上

奥野製薬工業(株) (大阪市中央区) は、パッケージ基板向けめっき添加剤「トップルチナNSV」の新製品として「トップルチナNSV ADV」を開発した。従来品と同等の品質を実現しつつ、生産性を2〜2.5倍に高めることができる。既存の顧客に加え、海外を中心に新規顧客にも拡販を目指す。

トップルチナNSVはフリンパターン形成に適したビアフィリング向けめっき添加剤で、約20年の実績があり、パッケージ基板のビルドアップ層向けで不動の地位を築いてきた。しかし、パターンめっきの膜厚ばらつき抑制とビアフィリング性の両立を大きな特徴とする反面、電流密度が1 A/dm²と低く、使用する

塩化物イオン濃度の管理が難しいことが課題だった。このため、高生産性を重視する用途には採用が広がらないことが難点だった。トップルチナNSV A



ADVによる「トップルチナNSV A」

ADVは、広く知られるトップルチナNSVを冠した新タイプとして開発された。2・5 A/dm²の高電流密度に対応して生産性を高めつつ、従来と同等の品質を実現できる。抑制剤の分子構造を最適化したことにより、膜厚均一性を改善したほか配線デザインはL/S=8/8μmに対応している。

一部の顧客向けにはすでに提案しており、10月のTPCAショーなどで展示会での紹介を通じて国内外に本格販売する。台湾を中心とした海外の顧客のほか、国内でも従来品が用いられていなかった用途の開拓を目指す。パッケージ基板向けとして、従来比で売り上げを倍増したい考えだ。

これに加え、同じくトップルチナNSVシリーズの新製品として「トップルチナNSV LV」を製品化した。主にMSAP向けで大口径のビアフィリングと良好な膜厚均一性を両立できる。また、スルーホールフィリングにも対応した。こちらも提案をすでに始めており、MSAP用途を中心に拡販を目指す。

